

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和7年7月31日

2. 供給確保計画の認定番号

2025半導体第2号－1

3. 供給確保事業者の名称等

DIC株式会社

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体部素材（半導体用エポキシ樹脂）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
半導体用エポキシ樹脂の国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：市原市（千葉県）
 - ・主要製品：半導体用エポキシ樹脂

生産場所	供給開始	生産能力
千葉工場 (市原市)	2029年7月	半導体用エポキシ樹脂の生産能力をおよそ 59%引き上げる

(※) 供給開始の日から10年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額：約90億円（最大助成額 約30億円）
- 希望する支援措置
助成金交付